

格科微有限公司

关于募投项目首批产能正式量产的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格科微有限公司（以下简称“公司”）募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”BSI产线于2022年8月31日投片成功，首个晶圆工程批取得超过95%的良率，详情参见公司于2022年9月3日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目投产的自愿性披露公告》（公告编号：2022-022）

目前，该项目已完成首批设备的安装调试，顺利产出了良率符合预期的合格产品，并通过了长期信赖性测试验收，达到大规模量产条件。随着更多设备安装并投产，产能将同步释放提升，最终将实现月产 20,000 片晶圆的产能。

根据规划，本次募投项目新增产能主要用于生产中高阶CIS产品，是在现有业务的基础上对产品线的完善与补充。公司创新的高像素单芯片集成技术及高性能的产品设计使得公司有能力消化本次新增产能。目前，公司1,300万、3,200万像素产品已通过部分客户验证，预计将于年内获得客户订单。在此基础上，后续公司将推出基于高像素单芯片集成技术的5,000万、6,400万、10,800万等更高像素规格产品。同时，该项目还有助于实现公司在芯片设计端和制造端的资源整合，提升在背照式图像传感器领域的设计和工艺水平，加快研发成果产业化的速度，有利于增强公司的核心竞争力，为公司提高市场份额、扩大领先优势奠定发展基础。

由于项目从正式量产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且即使全面达产，亦有可能面临因市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影

响，导致项目效益不及预期等风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023年6月13日